第六屆中國上海國際發明創新博覽會

**徵展**

商機無限

 把握機會報名參展

由中華人民共和國商務部、科學技術部、知識產權局、上海市人民政府主辦，來自世界最新發明創新產品，是一個由許多富有潛力的發明人和企業家向全世界展示概念，產品與服務的櫥窗。展覽會包括攤位，商業交流以及對參展者的媒體宣傳，是您最新開發商品拓銷最佳機會。特別為初芽新放的發明人、創新者及企業家提供一個發展潛力的平台，並為他們提供宣傳產品與服務的良機。

一、展出時間:2023年6月15日至6月17日

二、展出地點:上海世博展覽館(上海浦東新區國展路1090號)

三、報名日期:即日起至5月15日截止把握機會。

四、參展資格:最新研發新產品或申請中專利產品均可報名參加。

五、評 獎:含科技量高之創新產品將評選出金獎、銀獎、銅獎獎
牌、證書。

六、展 位 費:新台幣11000元(展位寬1米×深50公分，配射燈、固定展桌、附統一展版)。(每個展位報名1項展品參加評審)

七、費 用:展位費新台幣11000元、報名費5000元**、**評審費2000元(總計一件產品18000元)**。**

八、繳交資料:1、填妥報名表、2、繳納展位費及報名費、評審費。

 2、自備寬90公分高120公分電子檔海報(協會製作看板
之用)

 3、參展人兩吋照片1張，台胞證字號: 號

九、出國時間：如親自隨團前往現場參展者，出團時間預計6月14日
出發，6月17日返國。

十、團 費：估價中

十一、組團單位：台灣創新發明聯合總會（授權代理）

 台北市信義區崇德街90號2樓

E-mail:service@toiea.com.tw 電話02-2378-1366 傳真:02-2378-0023

請下載報名表:http://www.toiea.com.tw報名截止日:2023年5月15額滿即止。

**第五屆中**国（上海）国际发明创新博览会

**企业**参展项目情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 技术类别 |  |
| 单位 | 名称 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 地址 |  | 邮编 |  | 网址 |  |
| 第一发明人 | 姓名 |  | 区号 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 通信地址 |  | 手机 |  |
| 电子邮件 |  | 邮编 |  |
| 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  | 职务发明 |  |
| 文化程度 |  | 职务职称 |  | 非职务发明 |  |
| 其它发明人 |  |
| 专利情况 | 申请号 |  | 授权日期 |  | 授权专利号 |  |
| 参展方式 | 图片□ 模型□ 样品□ 声光电演示□ | 参展目的 | 转让技术□ 合作开发□ |
| 发明人类别 | 大专院校□ 科研院所□ 企业□ 工人□ 农民□ 自由职业□ 其它□ |
| 需求展位情况 | 标准展位（1m×1m） 个，非标准展位 m× m |
| 是否愿意展后在有关的交易平台上免费展示 | 是□ 否□ |
| 项目简介(200字，附1至3张项目照片制版用)。 |  |